

Communiqué de presse

Nouvelle monographie «Voltammetric analysis methods in electroplating»

Grâce à leur haute sélectivité et sensibilité, les méthodes d'analyses voltampérométriques sont devenues indispensables dans le domaine du traitement de surface et de la production de circuits imprimés.

Depuis le contrôle des bains jusqu'à l'analyse des effluents, la gamme d'applications est très large.

La nouvelle monographie «Voltammetric analysis methods in electroplating» fournit une vue d'ensemble complète des méthodes spécifiques liées à ce domaine et inclut également la détermination des additifs organiques.



La monographie décrit tout d'abord l'analyse des effluents dans l'industrie galvanique par voltampérométrie inverse : chrome, cyanure, nickel, cobalt, zinc, cadmium, plomb, cuivre, étain, agents complexants (EDTA et NTA). L'utilisation du digesteur UV 705 est également décrite pour permettre d'éliminer la matière organique souvent présente dans les effluents.

La seconde partie de la monographie décrit de façon très complète les analyses voltampérométriques de bains galvaniques.

Les différents types de bains sont ensuite listés, ainsi que leurs composants primaires et secondaires. Les principales méthodes d'analyse sont présentées pas-à-pas.

La monographie contient enfin de nombreuses références techniques très pratiques (bulletins d'application, notes d'application).

N'hésitez pas à demander votre exemplaire gratuit !

Mots-clé: Traitement de surface, galvanoplastie, électrodépôt voltammétrie, coating

Branches: fabrication de circuits imprimés, traitement de surface, industrie électronique